



# Crème à braser hydrosoluble **WSP 2006 SnPb(Ag)**

INTERFLUX®  
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique WSP 2006 SnPb(Ag)

Ver: 3.11 31-08-15

Page 1

## Crème à braser hydrosoluble sans halogènes

### Description

**WSP 2006 SnPb(Ag)** est une crème à braser hydrosoluble pour l'assemblage des composants CMS et la refusion.

Une crème hydrosoluble est sensible à un pourcentage d'humidité élevée et aux températures élevées. Il est recommandé de maintenir l'H.R. sous 60% et la température sous 30°C. Le temps entre la sérigraphie et la refusion devrait être le plus court possible.

La crème à braser **WSP 2006 SnPb(Ag)** possède de bonnes propriétés rhéologiques et une stabilité acceptable sur le pochoir ce qui lui donne une grande fenêtre de process en sérigraphie.

La crème a un bon mouillage sur la majorité des finitions

La crème à braser **WSP 2006 SnPb(Ag)** est absolument sans halogènes, sans résine et sans colophane.

Les résidus après refusion sont nettoyables à l'eau chaude (30-50°C) sans l'addition d'un produit saponifiant. Le nettoyage est obligatoire.

La crème est classée **OR MO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle

### Plus d'informations :

<i>Profil de refusion</i>	P. 2
<i>Recommandations sur le profil</i>	P. 2
<i>Manipulation</i>	P. 3
<i>Résultats des tests</i>	P. 3
<i>Recommandations pour les paramètres</i>	P. 4

### Avantages :

- Absolument sans halogènes
- Temps du pouvoir collant: >4 heures \*
- Bon mouillage sur la majorité des finitions
- Résidus facilement nettoyables à l'eau chaude

\* conditions de test sur simple demande

## Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn63Pb37			
Sn62Pb36Ag2	sérigraphie: 88%	Standard: classe 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g cartouche:
SnPbAg — AT	Dosage: 85%	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains al- liages	6Oz: 500g/600g/700g 12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg seringue: 5CC/10CC/30CC
Autres alliages sur demande			autres conditionnements sur demande



## Profil de refusion

### Description Générale

Les profils de refusion linéaires ou avec un palier sont possibles. Des profils avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants ou bien pour di-

minuer ou éliminer la présence de « voids ». Avec la refusion par convection il faut atteindre le pic de refusion à 300s du début du profil. La bonne vitesse du convoyeur peut être calculée en divisant la longueur totale des zones de chauffage par la durée désirée du profil.

Quand vous brasez une carte avec un four à refusion, faites attention à ne pas surchauffer les composants, en particulier quand vous utilisez de la convection ou de l'infrarouge. Il est important de connaître les limites de températures de vos composants. Pour avoir une

bonne appréciation de l'état thermique de votre carte, contrôlez votre profil de refusion avec des thermocouples. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en températures situés sur les côtés, au milieu et à proximité des gros composants.

## Recommandations pour le profil

### Préchauffage

De la température ambiante jusqu'à environ 170°C une pente de 1-3°C/s est conseillée. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité absorbée.

### Palier

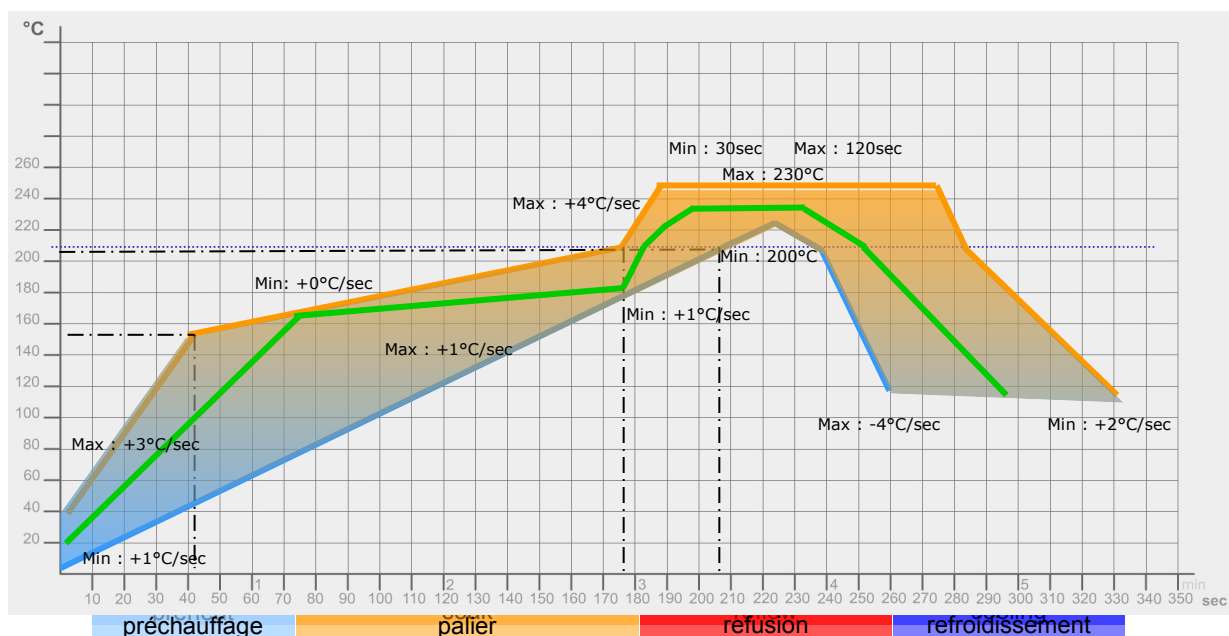
A partir de 120°C jusqu'à environ 170°C avec une pente de 0-1°C/s, un palier de 20s à 90s est souvent utilisé pour rendre homogène les différences de températures sur la carte ou afin de réduire la présence de "voids".

### Refusion

Le pic de refusion dépend des spécifications des composants. En général entre 200°C et 230°C. Le temps au dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

### Refroidissement

Environ - 4°C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.





## Manipulation

### Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° à 7°C.

### Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger la crème avant toute utilisation.

### Sérigraphie

Une crème hydrosol-

uble est sensible à l'humidité élevée et aux températures élevées. Si possible, il est recommandé de maintenir l' H.R. sous 60% et la température sous 30°C. Ne laissez pas la crème à braser sur le pochoir quand ce n'est pas nécessaire. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter

de la crème à intervalle régulier.

### Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie.

### Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et

fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie avant toute utilisation en production.

### Nettoyage

Le nettoyage est obligatoire. Les résidus après refusion sont nettoyables à l'eau chaude (30°C-50°C) sans ou avec l'addition d'un produit saponifiant. Finaliser avec un rinçage avec de l'eau déminéralisée pure, c'est obligatoire.

## Résultats des tests de fiabilité

conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Chimique</b>		
Miroir de cuivre	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Argent chromate (Cl, Br)	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
«Spot test» (F)	<b>passé</b>	J-STD-004 IPC-TM-650 2.3.35.1
<b>Environnement</b>		
	<b>passé</b>	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
<b>Mécanique</b>		
Test d'effondrement	22°C 0,63mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,33mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,22mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	150°C 0,63mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,33mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	0,22mm	<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
Test de mouillage		<b>passé</b> J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45



## Recommandations et Paramètres d'utilisation

### Sérigraphie

Vitesse : 20—70 mm/sec  
Pression racles :  $\pm 250$ g /cm

Nettoyage : Toutes les 10 cartes  
température d'utilisation : 15°C to 25°C

### Pose des composants

Pouvoir collant « tack time » : > 4 heures

### Refusion

Profil de refusion : Linéaire ou avec palier  
Type de chauffe : Convection, phase vapeur,...

Test "in situ": appropriée pour: "flying probe"  
Planche à clous

Nom commercial du produit : WSP 2006 SnPb(Ag) Water Soluble Solder Paste

### CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

**INTERFLUX®** ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

[www.interflux.com/fr](http://www.interflux.com/fr)

Le document dans une autre langue?:

[www.interflux.com](http://www.interflux.com)